

日刊

THE NIKKAN

工業

KOGYO SHIMBUN

新聞

12月30日 水曜日

2015年（平成27年）

## エムダイヤが剥離装置

## 基板1枚5—10秒で処理

【富山】エムダイヤ（富山県滑川市、森弘吉社長、076・476・0062）は、パソコンや電化製品の基

板上の電子部品を削り取る剥離装置（写真）を完成した。基板サイ

ズ300ミリ×300ミリに対応する。本体価格は800万—1000万円（消費税抜き）で、2016年春の発売を目指す。

抵抗器や中央演算処理装置（CPU）、接



続端子などが電子部品が搭載された基板をコンベヤーで運び、機械内部の刃で削り取る。一般的なパソコン用基板は1枚約5—10秒で処理できる。刃の深さを調整すれば多様な基板に対応する。大手電機メーカーや基板リサ

イクル処理業者などから引き合いもある。

開発は国のものづくり補助金を活用し、同社の分離・破砕機「エコセパレ」の剥離技術を応用した。今後は携帯電話などに使用されている小型基板や、表裏両面に電子部品が搭載されたタイプに対応できるように検討する。